

公司代码：600584

公司简称：长电科技

江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股本1,788,827,976股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利178,882,797.60元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴宏鲲	袁燕
办公地址	江苏省江阴市滨江中路275号	江苏省江阴市滨江中路275号
电话	0510-86856061	0510-86856061
电子信箱	IR@jcetglobal.com	IR@jcetglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为半导体芯片成品制造和测试子行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于通信类、高性能计算、消

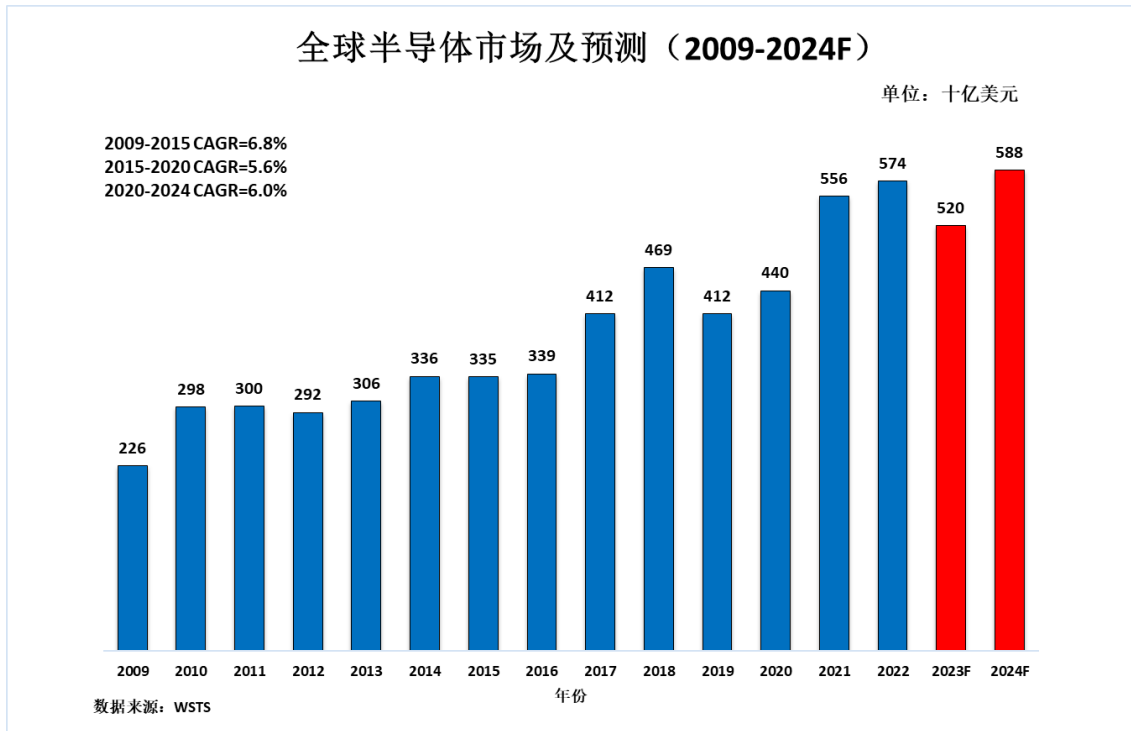
费类、汽车和工业等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路晶圆制造、集成电路芯片成品制造和测试三个子行业。

1) 半导体市场情况

2023 年受到全球经济衰退的影响，全球消费电子市场疲软，全球半导体市场处于行业下行周期。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据，预计 2023 年全球半导体市场规模为 5,200 亿美元，同比下降 9.4%；从地区看，预计 2023 年美洲、日本和亚太地区同比分别下降 6.1%、2.0%、14.4%，欧洲市场同比增长 5.9%。

随着消费需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用下，预计 2024 年全球半导体市场将重回增长轨道。从应用端看，存储器市场将成为 2024 年半导体市场复苏最主要的推动力，WSTS 预计其市场将高速增长，同比涨幅为 44.8%。另外，据市场调查机构 IDC 数据，预计到 2027 年全球人工智能总投资规模将达到 4,236 亿美元，近 5 年复合年增长率为 26.9%。其中中国将达到 381 亿美元，占全球总投资 9%。IDC 数据也显示，2023 年第四季度全球传统 PC 出货量略高于预期，出货量近 6,710 万台，比去年下降 2.7%。市场萎缩似乎已经触底，预计将在 2024 年实现增长。同时，IDC 预估 2024 年全球智能手机出货量 12 亿部，同比增长 2.8%；其表示大模型技术将推动手机进入 AI 时代，预计 2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达到 1.7 亿部，占智能手机整体出货量的 15%。

从全球半导体产业发展的历史情况来看，半导体产业具有一定的周期性。

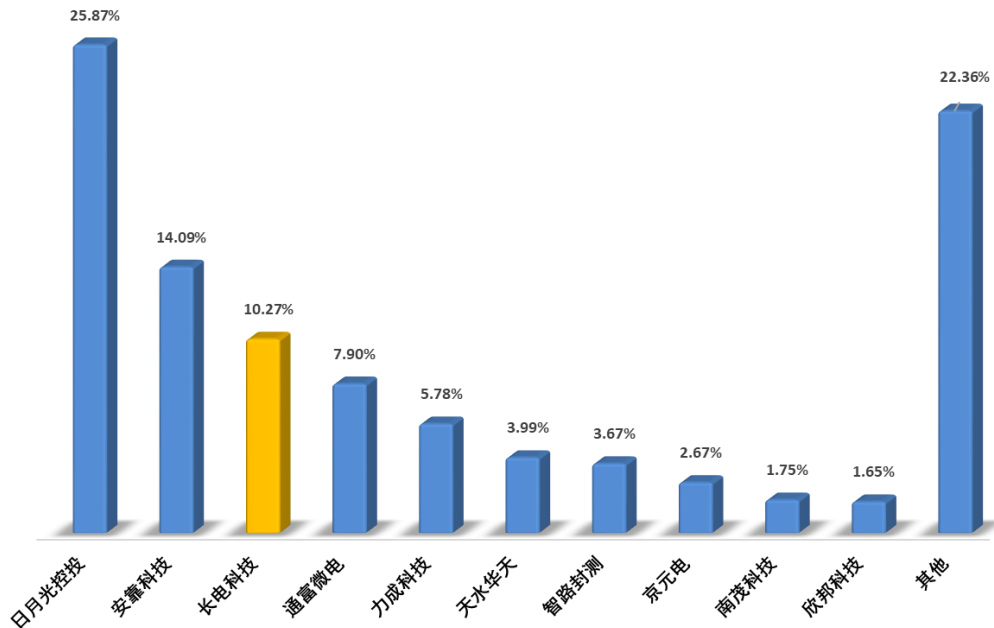


2) 公司的行业地位

根据芯思想研究院 (ChipInsights) 发布的 2023 年全球委外封测 (OSAT) 榜单，长电科技以预估 294 亿元营收在全球前十大 OSAT 厂商中排名第三，中国大陆第一。公司在品牌领导力、多元化团队、国际化运营、技术能力、品质保障能力、生产规模、运营效率等方面占有明显领先优势。

从近五年市场份额排名来看，行业龙头企业占据了主要的份额，其中前三大 OSAT 厂商依然把控半壁江山，市占率合计超过 50%。

2023年全球委外封测市场占有率



数据来源：芯思想研究院2024年2月发布
注：市场占有率数据不包括IDM对外封测和晶圆代工公司提供的封测营收

3) 半导体行业上下游情况

集成电路产业链包括集成电路设计、集成电路晶圆制造、芯片成品制造和测试、设备和材料行业。公司所属芯片成品制造与测试位于产业链中下游，是集成电路产业链上重要的一个环节。集成电路芯片成品制造与测试的客户是集成电路设计公司和系统集成商，设计公司设计出芯片方案或系统集成方案，委托集成电路制造商生产晶圆（芯片），然后将芯片委托封测企业进行封装、测试等，再由上述客户将产品销售给电子终端产品组装厂。

集成电路芯片成品制造行业的供应商是设备和材料。原材料的供应影响芯片成品制造行业的生产，原材料价格的波动影响芯片成品制造行业的成本。

4) 报告期内公司业务情况

长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。公司在中国、韩国及新加坡拥有两大研发中心和六大集成电路成品生产基地，业务机构分布于世界各地，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

通过高集成度的晶圆级 WLP、2.5D/3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、汽车电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。

最近几年公司加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子、高性能计算、存储、5G 通信等高附加值市场的战略布局，持续聚焦高性能封装技术高附加值应用，进一步提升核心竞争力。公司 2023 年度营业收入按市场应用领域划分情况：通讯电子占比 43.9%、消费电子占比 25.2%、运算电子占比 14.2%、工业及医疗电子占比 8.8%、汽车电子占比 7.9%，与去年同期相比通讯电子增长 4.6 个百分点，消费电子下降 4.1 个百分点，运算电子下降 3.2 个百分点，工业及医疗电子下降 0.8 个百分点，汽车电子增长 3.5 个百分点。

公司主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准或行业标准提供专业和系统的集成电路成品生产制造、测试以及全方位的端到端的一站式解决方案。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	42,579,471,835.65	39,407,731,739.01	8.05	37,098,618,885.51
归属于上市公司股东的净资产	26,065,635,116.80	24,642,733,205.19	5.77	20,991,131,608.04
营业收入	29,660,960,881.35	33,762,028,449.00	-12.15	30,502,417,851.52
归属于上市公司股东的净利润	1,470,705,571.95	3,230,988,205.53	-54.48	2,958,712,532.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,322,571,351.51	2,829,869,778.93	-53.26	2,486,571,359.81
经营活动产生的现金流量净额	4,436,698,567.22	6,012,468,403.84	-26.21	7,428,671,369.12
加权平均净资产收益率(%)	5.81	14.19	减少8.38个百分点	16.42
基本每股收益(元/股)	0.82	1.82	-54.95	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.81	-54.70	1.72

公司主要会计数据的说明

报告期内，全球终端市场需求疲软，半导体行业处于下行周期，导致客户需求下降，产能利用率降低。同时，受价格承压影响，整体利润下降。基于以上因素，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，相关指标也呈不同比率下降，包括：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

公司积极应对市场变化，持续强化以应用为核心的创新发展模式，优化业务结构，促进聚焦于高性能先进封装的产品升级转型，同时继续加大精益智造和降本增效力度，经营业绩逐季回暖反弹。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	5,860,195,186.42	6,312,656,311.81	8,256,991,033.04	9,231,118,350.08
归属于上市公司股东的净利润	109,928,612.98	385,661,515.96	478,073,221.87	497,042,221.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,290,404.61	322,593,075.66	367,867,248.58	575,820,622.66
经营活动产生的现金流量净额	1,233,739,882.22	1,187,116,800.87	612,290,459.56	1,403,551,424.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					227,090		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					226,852		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	236,897,906	13.24	0	无		国有法人
芯电半导体（上海）有限公司	0	228,833,996	12.79	0	无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	55,727,021	98,422,105	5.50	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—银河 创新成长混合型证券投资基金	39,000,000	39,000,000	2.18	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司— 华夏国证半导体芯片交易型开 放式指数证券投资基金	4,158,700	33,390,751	1.87	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司— 国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投 资基金	6,562,415	24,241,796	1.36	0	未知		未知
无锡金投领航产业升级并购投 资企业（有限合伙）	-10,415,700	23,163,883	1.29	0	无		境内非国 有法人
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开 放式指数证券投资基金	3,646,400	18,262,194	1.02	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—兴全 合润混合型证券投资基金	16,439,820	16,439,820	0.92	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—兴全 趋势投资混合型证券投资基金	14,999,797	14,999,797	0.84	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司无实际控制人，前两大股东分别为：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司，前两大股东之间不存在任何一致行动关系，其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1) 报告期内，公司全年实现营业收入 296.61 亿元，同比减少 12.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.71 亿元，同比减少 54.48%。

2) 公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权

公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电管理以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“晟碟半导体”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，长电管理持有晟碟半导体 80%股权，出售方持有晟碟半导体 20%股权。详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》（公告编号：临 2024-015）。

3) 公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更

公司于 2024 年 3 月 26 日收到通知，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别与磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份 174,288,926 股（占公司总股本的 9.74%），以 29.00 元/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份 228,833,996 股（占公司总股本的 12.79%），以 29.00 元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。磐石香港控股股东为华润（集团）有限公司，实际控制人为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）。

本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本 13.24%和 12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有公司 403,122,922

股份，占公司总股本的 22.54%。公司控股股东将变更为磐石香港或其关联方，实际控制人将变更为中国华润。

本次股份转让完成后，股东大基金持有的股数由 236,897,906 股变更为 62,608,980 股，占公司总股本的 3.50%；股东芯电半导体不再持有公司股份。

详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2024-024），以及于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（国家集成电路产业投资基金股份有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书（芯电半导体(上海)有限公司）》、《江苏长电科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：高永岗

二〇二四年四月十七日